



## 經濟部國際貿易署 115 年智慧機械海外推廣計畫

### 徵集臺灣海外推廣菁英團 | 前進馬來西亞 SEMICON SEA 2026 東南亞半導體展

#### 一、邀約目的：

攜手推動臺灣電子設備產業之國際形象，提升在東南亞市場之能見度；並透過 SEMICON SEA 平台，促進臺灣廠商與國際買主、當地公協會及產業夥伴之交流合作，進一步創造實質商業媒合與合作機會。

#### 二、活動資訊

SEMICON SEA 2026 馬來西亞國際半導體展

- 115/05/04 (展前) | 產業交流餐會
- 115/05/05–05/06 | 產品發表會
- 115/05/05–05/07 | 產品與形象展示

#### 三、徵集類別與名額

【A 類廠商】(已報名 SEMICON SEA )

預計徵集：5 家

提供資源：

1. 產品發表會 1 場 (約 15 分鐘)
2. 當地專業媒體專訪報導
3. 整合式曝光宣傳 (線上 / 線下)

【B 類廠商】(未報名 SEMICON SEA )

預計徵集：8 家

提供資源：

1. 產品發表會 1 場 (約 15 分鐘)
2. 當地專業媒體專訪報導
3. 整合式曝光宣傳 (線上 / 線下)
4. 專屬展示台與形象海報露出

#### 四、申請資格 (符合下列條件者優先)

1. 臺灣合法登記之半導體產業相關電子設備、智慧製造或相關解決方案廠商
2. 具備具國際競爭力之創新技術、產品或服務者
3. 須配合計畫團隊所規劃主題發表相關產品或分享成功案例
4. 具備英文簡報能力，並可提供英文宣傳文稿、圖片及影音等相關素材
5. 願意為本計畫共同宣傳並配合本計畫相關活動出席
6. 需出席展前產業交流餐會 (若臺灣廠商無法出席，可由當地代理商代表)
7. 有展示台之廠商須於展期間派員駐守臺灣形象展示區，負責產品展示與解說，並共同提升臺灣產業國際形象。

## 五、您一定要參加本計畫的五大理由

### **1-商談媒合 | 精準對接在地買主**

邀請馬來西亞及東南亞地區買主、公協會與產業代表，透過展前交流餐會與展期間媒合活動，協助臺灣廠商建立合作管道，順利切入在地產業生態鏈。

### **2-集客曝光 | 產品發表 x 展示台整合行銷**

除實體展示外，量身規劃產品發表會，結合線上形象館與行銷影片播放，打造完整的整合行銷曝光機制。

### **3-數位行銷 | 海外精準宣傳資源**

展前運用 Facebook、LinkedIn 等數位平台，精準鎖定馬來西亞半導體產業族群，提升臺灣品牌於海外市場的能見度與專業形象。

### **4-實體宣傳 | 大會廣告與專屬宣傳物**

製作大會宣傳物、產品型錄及展場廣告露出，吸引專業觀眾關注，全面放大參展效益。

### **5-媒體邀訪 | 國際曝光與產業連結**

安排當地專業媒體專訪，並邀請在地公協會代表參與，強化品牌曝光，促進後續合作機會。

## 六、成為菁英團後，您需要配合事項

1. 提供產品、技術或服務之相關資訊。
2. 協助配合本計畫活動之展前、展中及展後宣傳作業。
3. 配合出席本計畫相關線上或線下活動(若臺灣廠商無法出席，可由當地代理商代表)。
4. 配合填寫「參展效益滿意度」問卷調查。

## 七、其他說明：

本方案不補助展品運送費、機票、住宿、人力等相關業務費用。

## 八、聯絡窗口方式

台灣電子製造設備工業同業公會

藍凱琳 Karen

02-27293933#26 [karen@teeia.org.tw](mailto:karen@teeia.org.tw)

財團法人精密機械研究發展中心

楊欣瑜 Amber

04-23599009 #522 [e11107@mail.pmc.org.tw](mailto:e11107@mail.pmc.org.tw)

**報名截止日期：115 年 1 月 30 日 (五)**

因名額有限，主辦單位保有審核及遴選參與廠商之權利，並將於 2 月 6 日前另行通知確認入選廠商。

## 主辦單位

經濟部國際貿易署

## 執行單位

財團法人精密機械研究發展中心

中華民國對外貿易發展協會

## 協辦單位

台灣電子製造設備工業同業公會